

北京京运通科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资公司名称：乐山市京运通半导体材料有限公司（以下简称“乐山半导体”）
- 增资金额：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京运通”）拟以前期投入的资金 114,955.00 万元（人民币，下同）对全资子公司乐山半导体进行增资。
- 本次增资事宜不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次增资事宜已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无须提交公司股东会审议。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据公司战略布局和经营发展的需要，为了提高乐山半导体的资金实力并优化其资产负债结构，公司拟以前期投入的资金对乐山半导体增资 114,955.00 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以前期投入的资金对乐山半导体增资 114,955.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项无须提交公司股东会审议。

(三) 本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资子公司的基本情况

(一) 增资子公司基本信息

- 1、公司名称: 乐山市京运通半导体材料有限公司
- 2、统一信用代码: 91511112MA69W58Q8J
- 3、注册资本: 45,045.00 万元
- 4、成立时间: 2021 年 9 月 7 日
- 5、法定代表人: 谢月云
- 6、注册地址: 四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号
- 7、经营范围: 一般项目: 电子专用材料制造; 光伏设备及元器件制造; 电子专用材料研发; 光伏设备及元器件销售; 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳素制品销售; 半导体器件专用设备制造; 半导体器件专用设备销售; 机械电气设备销售; 非金属矿物制品制造; 非金属矿及制品销售; 太阳能热利用装备销售; 太阳能热利用产品销售; 机械电气设备制造; 电子专用材料销售; 机械设备租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 科技中介服务; 货物进出口; 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二) 股权结构

公司直接及间接持有乐山半导体 100% 股权。

(三) 最近一年又一期的主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日, 乐山半导体资产总额 312,136.42 万元, 负债总额 294,278.23 万元, 净资产 17,858.19 万元, 资产负债率为 94.28%; 该公司 2023 年度实现营业收入 70,568.60 万元, 净利润-9,625.41 万元。(以上数据已经审计)

截至 2024 年 9 月 30 日, 乐山半导体资产总额 333,852.36 万元, 负债总额 320,209.43 万元, 净资产 13,642.93 万元, 资产负债率为 95.91%; 该公司 2024 年 1-9 月实现营业收入 79,672.49 万元, 净利润-39,620.26 万元。(以上数据未经审计)

三、本次增资方案

公司本次拟以前期投入的资金 114,955.00 万元增加乐山半导体注册资本。

增资前后，乐山半导体注册资本变化

单位：万元

被增资对象	增资方案实施主体	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
乐山半导体	京运通	45,045.00	114,955.00	160,000.00

四、本次增资对公司的影响

本次公司以前期投入的资金对全资子公司乐山半导体进行增资，有利于优化其资产负债结构、提升其资金实力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情况，增资完成后乐山半导体仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024年10月30日